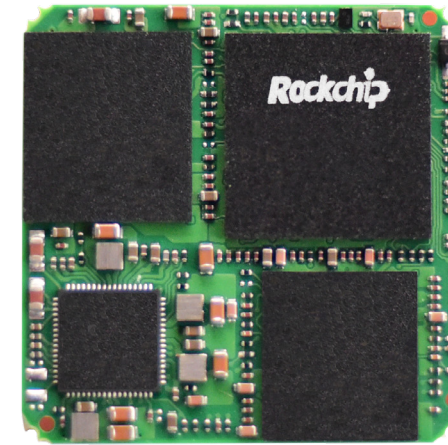


Embedded Module mit Rockchip PX30

Open Standard Module™ - iesy RPX30 OSM-SF

Technisches Konzept

- ▶ Prozessor: PX30 Quad-Core A35
- ▶ Taktrate: 1,5 GHz
- ▶ Arbeitsspeicher: 1 GByte LPDDR3
- ▶ Flash Speicher: 8 GByte e-MMC 5.1
- ▶ Abmessung: 30 mm x 30 mm
- ▶ Footprint: OSM Size-S
Land Grid Array (LGA) mit 332 Kontakten
- ▶ Spannungsversorgung: Single Supply 5VDC
- ▶ Temperaturbereich:
 - > Im Betrieb: -40 °C bis +85 °C
 - > Lagerung: -40 °C bis +85 °C
- ▶ Leistungsaufnahme: 0,3 W (typ.) / 1,8 W (max.)
- ▶ Funktionen & Schnittstellen
 - > 1 x LAN 10/100 (RMII)
 - > 2 x USB 2.0 Client/Host/OTG
 - > 1x MIPI DSI (4 Lanes)
 - > 1x MIPI CSI (4 Lanes, incl. I2C)
 - > 1x SD-Card
 - > 2x SPI, 2x UART, 1x Debug-UART
 - > 2x I2C, 1x I2S
 - > 18x GPIO
 - > 2x ADC (10 bit, SAR), 4x PWM



Über OSM™

Die Open Standard Module™ Spezifikation wurde 2019 von der SGeT e.V. verabschiedet. Der neue Standard wurde entwickelt, um zukünftigen Anforderungen in Bezug auf **Flexibilität**, **Skalierbarkeit**, aber auch der **Kostenreduktion** gerecht zu werden. OSM™-Auflötmodule können individuell an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden. Dazu können die einzelnen Module mittels Tray & Reel im **SMT-Prozess** automatisch verarbeitet werden. Die OSM™ Serie umfasst insgesamt vier verschiedene Formfaktoren.



iesy.com/osm